

Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, **United Monolithic Semiconductors** implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une joint-venture créée en 1996 entre **Thales et AIRBUS Defence and Space GmbH**.

Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON SUR YVETTE (91) (RER B MASSY PALAISEAU) un(e) :

## **Ingénieur Développement Packaging Hyperfréquences - (H/F)**

Intégré(e) au Groupe Packaging, vous participez au développement et à la conception de nouveaux boîtiers hyperfréquences : boîtiers dans les familles QFN, BGA, FO-WLP, Métal Céramique qui permettront d'intégrer les nouveaux composants MMIC développés par UMS. Les domaines d'application des boîtiers sont l'automobile, la défense, l'espace et les télécommunications.

### **QUI ETES-VOUS ?**

De formation supérieure en électronique option hyperfréquences ou microélectronique (Ingénieur ou Universitaire), vous avez acquis une expérience dans le domaine de la conception de boîtiers ?

Vous avez de bonnes compétences en électronique Hyperfréquences ?

Au cours de vos précédentes expériences (stages, alternance, thèse CDI, CDD), vous avez développé votre aptitude à accroître vos compétences, votre créativité et le sens du travail en équipe avec une bonne communication ?

### **CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :**

Vous serez amené(e) à assurer

- Une participation à la définition des spécifications et la proposition de solutions techniques d'encapsulation,
- La conception, le dessin et l'optimisation des boîtiers avec des outils de simulation électromagnétique (CST...), thermique et thermomécanique,
- La validation de la robustesse des boîtiers développés dans le respect des règles de fabrication des sous-traitants, et des exigences de fiabilité et de qualité,
- Les échanges techniques avec les acteurs du processus de fabrication en interne et en externe (Sous-traitants d'assemblage en Europe et en Asie),
- La conception des cartes de tests assurant la testabilité des boîtiers développés en lien avec le bureau d'études,
- Une contribution active à la caractérisation et à la fiabilisation des boîtiers développés (lors des phases de mesures et des essais de fiabilité),
- L'organisation et le suivi des tâches relatives à votre projet jusqu'à la qualification des boîtiers développés.
-